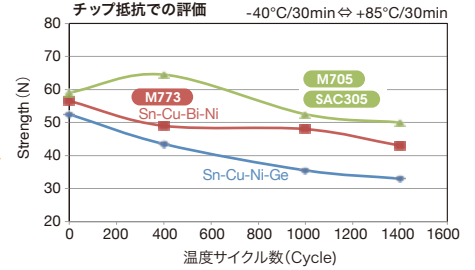


信頼性を確保しながら無銀化に成功、低価格化に貢献

Contribute Cost Reduction by Low-Ag without Sacrificing Reliability

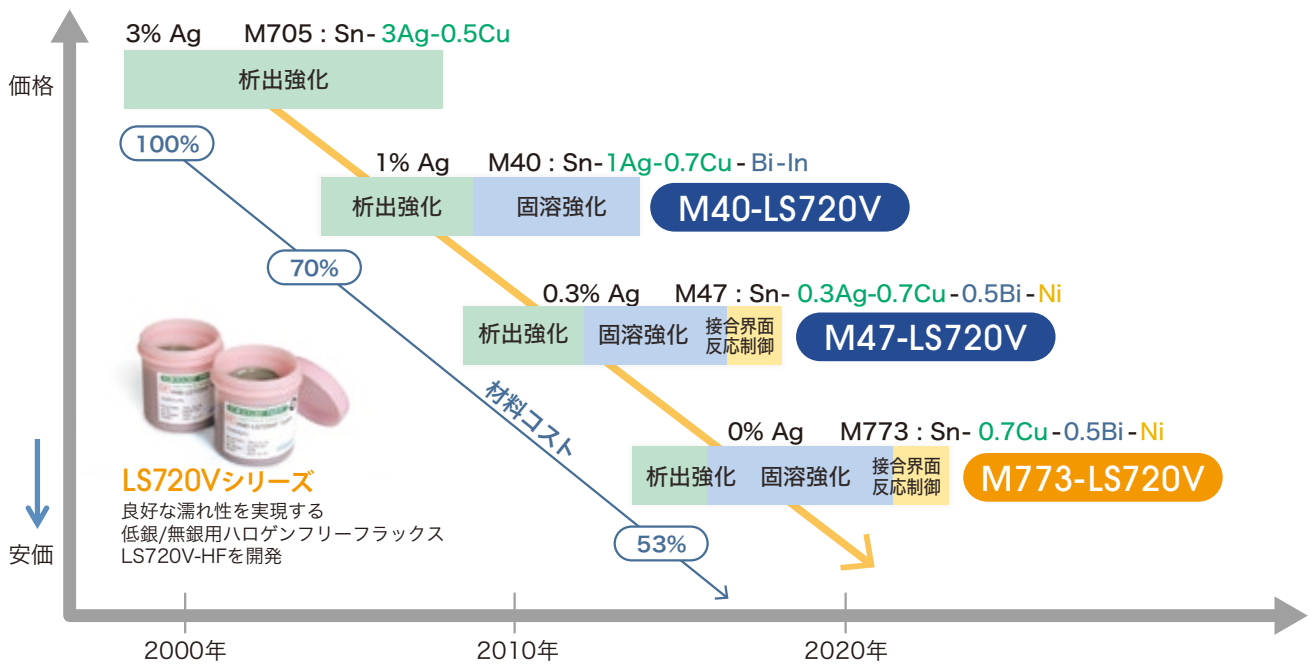
特長

- 業界のハロゲンフリー基準を満足するLS720Vシリーズ、モバイル機器にも
- M705と同等のプロファイルで実装可能な、M40-LS720V
- 0.3%Agでも、M705と同等な耐熱疲労性を有する、M47-LS720V
- BiとNiの添加でSn-Cu系はんだの接合信頼性を高めた、M773-LS720V



Revolutionary Products

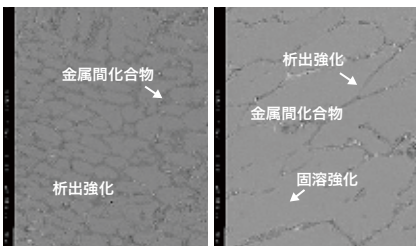
信頼性を維持しつつ、低銀&無銀化はんだで実装



● 固溶強化との併用

Ag量低下による、析出強化の低下を固溶ける強で補う

M705 固溶強化: 異質な原子の混入で変形を抑制
M40



● 接合界面反応抑制技術

NiがCuへ置換する事で、接合界面組織が微細化され接合強度が向上

M705 リフロー 1回, リフロー 4回
M773 リフロー 1回, リフロー 4回

